

## 株式会社アドバンテスト

### 2024年3月期(2023年度)第1四半期決算説明会 質疑応答要旨

2023年7月26日(水)

- Q: 今回の説明会では、来期に向けて期待が持てる話が多かった。4月の決算説明会では、2024年のテスト市場は2022年のピークを越える可能性も示唆していたが、その確度が高まったのか、見通しの根拠について教えてほしい。
- A: 4月の説明会では、当社の2024年度の売上高は2022年度の水準まで戻る可能性があるとお話した。足元はスマートフォン関連とPC関連が低調だが、この状態がいつまでも続くとは考えていない。回復に向かう時期は少し遅れる見通しであるが、一部の顧客ではテストの稼働率は高まってきており、2024年度に向け、徐々に設備余剰は解消に向かうと見込んでいる。また、メモリ半導体の市場は、各社の業績はかなり厳しい状況であるが、生成AIに触発された需要に対して、前向きな投資が出てきている。生成AIの社会実装の進展に伴い、急角度な需要拡大を期待する声が当社の顧客である主要なファウンドリーやファブレス企業からも聞こえてきている。
- それらを踏まえると、今期の落ち込みが深い分、急なカーブで需要は上がる可能性はあるが、現在のところ、当社テストの需要予測のジビリティは限られている。また、世界経済の状況や、中国経済、および地政学的リスクなど慎重に見極める必要がある。
- Q: 生成AIに関連したGPUやASICなど、プロセッサ向けテストビジネスで、御社は高いシェアを保有していると認識している。競争環境を踏まえてシェアの見通しはいかがか。
- A: 生成AI関連のプロセッサにおいて、当社は大きなシェアを有している。GPUのリーディングカンパニーを含め、AI関連の世界中の顧客にエンジニアリングサポートを続けて、信頼関係を構築し、長期にわたりエンゲージメントを深めている結果である。加えて、ファブレス企業のパートナーであるファウンドリーやOSATについても、長年の時間をかけて協力関係を構築してきた。今後も必要となるソリューションを提供し続け、強いポジションを維持していけると考えている。
- Q: 2023年度ガイダンスの四半期の推移について教えてほしい。2Q売上高はQoQで10%強増加する見通しで、下期売上高はHoHで25%近くの増加となる見通しだが、3Q、4Qはそれぞれどのような見通しか。
- A: OSATの稼働率改善とハイエンドメモリ需要に鑑み、下期の売上高増加を見込んでいる。QoQでは、1Qから四半期ごとに売上高は高まる見通しであり、4Qは3Qより高くなると想定している。4Q売上高は前年同期と同水準を見込めるのではないかと感じている。

過去数年、SoC テスタ事業ではスマートフォン関連向けの需要けん引により、高い売上高を計上、OSAT 顧客を中心に設置台数が伸びた。今期はスマートフォン関連需要が落ち込んでいるため稼働率はかなり低下したものの、足元では少しずつ改善に向かいつつあり、下期に向けて新規テスタ装置の導入など、追加の需要が少しずつ増加すると見込んでいる。他方、メモリについては生成 AI 向け HBM を中心にハイエンドメモリ向けの需要が増えている実感がある。

Q: 2023 年度 4Q の売上高は、前年同期に近い水準になるとの説明があったが、4Q に需要が高まると理解してよいか。またその需要の背景は何か。

A: 3Q、4Q の売上高を明確にお話しするのは時期尚早であるが、メモリ関連の投資を中心に、需要の高まりを期待している。HBM など AI 関連でのメモリテスタ需要は、顧客が生産数量を上げるために、来期予算で急速な投資を開始していく感触を得ており、3Q よりも 4Q のほうが売上高が高まると見込んでいる。

Q: 2024 年のテスタ市場は 2022 年並みではないかと先ほど説明があったが、生成 AI 関連でのテスタ市場へ与える影響はいかがか。

A: 生成 AI がもたらすテスタ市場規模の今後見通しを、現時点で定量的に言及することは難しいが、AI/HPC 関連でのテスタ需要は、アプリケーション・プロセッサに伴うテスタ需要に対して、今後同等以上になると見込んでいる。これまでの過去5年を振り返ると、スマートフォン関連の技術進化がテスト需要をけん引し、当社の売上高を伸ばしてきた。足元はスマートフォン関連の需要は弱含んでいるものの、今後も技術進化に伴うテスト需要の増加は見込まれ、2024 年以降一定の回復を見込んでいる。さらに、AI/HPC 関連需要の伸びを合わせると、高性能半導体向けテスト需要は拡大するものと見込んでいる。

Q: 3 か月前と比較したスマートフォン関連の需要見通しはいかがか。2023 年の SoC テスタ市場見通しを下方修正している一方で、2023 年度の業績予想を据え置いた理由を伺いたい。

A: スマートフォン関連の需要は3か月前の想定より回復が長引くと見込んでいる。調査会社の予測でもスマートフォンの販売台数見通しが過去の 13-14 億台に対して 12 億台を割り込むレベルの足元の水準の中、テスト需要においても OSAT での稼働率改善が長引くとみている。その回復には、年末から来年度初頭のころまでかかる可能性もあり、市場規模予想を引き下げる見通しに反映した。一方、当社の 2023 年度の業績予想を据え置いた理由の一つは、2Q 以降の為替前提を円安方向に見直したことが影響している。また、スマートフォン関連需要は弱いものの、ディスプレイ・ドライバー IC や CMOS イメージセンサーなど、それ以外のテスタ需要は期初予想より局所的に回復が見られること

や、HBM などメモリ向けの需要の強さが SoC の弱さを補い、期初計画を維持できるのではないかと見込んでいる。

Q: 23 年 3 月期末まで開示されていた受注残高をベースに考えて、当時の部材調達難に起因した長い製品リードタイムが続いていたことを踏まえると、この1Q の売上高はもう少し高くなると予想していた。リードタイムの長期化や、部材調達のボトルネックは、現在解消されていると理解して良いか。

A: 部品調達のボトルネックに関しては、一部の半導体を除き、ほぼ解消されつつある。昨年末で 12 か月程度であった当社製品のリードタイムは、現状は6か月程度まで短縮してきている。1Q の売上高は、受注残の中でも顧客からの納入延伸の要求があり、その分後ろ倒しになっていることを反映している。

Q: 1Q は売上高が前年同期比で約 350 億円減少している一方で、販管費は約 30 億円増加。内訳として研究開発費が 15 億円増加していることは理解できるが、その他の増加要因は何か。また、2Q 以降の四半期ごとの販管費の水準について、その大部分は固定費と思われるので、増収率ほど販管費は増えないのか。

A: R&D 人財含め、人件費の上昇等が販管費の増加につながっている。加えて当社グループで海外人財が非常に増えている中で、円安による費用増も大きな要因。収益性の観点で販管費をしっかりとコントロールしながら、通期売上予想 4,800 億円を達成していく。一方で 2024 年度以降に市場は回復してくると見込んでいるため、その際に必要となる人財の投資は継続しなければならないと考えている。削るべき経費は削るなどして利益を確保しつつ、必要な R&D 投資や人財投資は続けていきたい。

Q: 棚卸資産が膨らんでいるが、完成品在庫と戦略的に調達している長納期部品の受け入れとどちらの影響が大きいのか。

A: 主として半導体材料の在庫の増加の影響が大きい。長納期部品を戦略的に調達する中、昨年前半に発注した部品の在庫が計上されている。一方、当社製品に対する出荷のプッシュアウト要請も出ており、売上の様子を見ながら納入の交渉含めた在庫管理をしていく必要がある。棚卸資産に占める完成品在庫そのものの比率はそれほど大きくない。

Q: HPC 関連で顧客数の増加について話があったが、最大手 GPU 顧客以外の動きを教えてください。4 月の説明会では開発を終え、量産に入る顧客もいるとの話があったが、進捗はどうか。

A: 多様な半導体の開発の動きは広がっていると感じるものの、量産向けのテスト需要が顕在化してくるにはもう少し時間がかかると見込んでおり、2024 年に期待している。

サーバー向け AI 関連半導体では、ハイパースケーラーの自社開発チップのほかに、GPU、HBM など関連する半導体が揃わないと量産体制に移行できない環境がある。また、ファウンドリーや OSAT などの量産拠点での能力増強を待つ状況もある。例えば GPU 顧客では、そのような能力増強が実現すれば、増産に移行できるという現状がある。

サーバー向け以外でも、半導体開発に取り組んでいる企業もあるが、その量産計画には市況の影響も考慮する必要がある。

- Q: ハイエンド SoC のテスト時間について教えてほしい。同じプロセスノードを採用する場合、AI 用のプロセッサとスマートフォン用のプロセッサの1チップ単位当たりのテストタイムは、どのくらい長いのか。
- A: 具体的なテストタイムは顧客の機密情報のため、当社からの回答は控えさせていただきたい。ただ、データセンタなどに採用される AI プロセッサは、より高いレベルの品質保証が必要とされる。ウエハテストやパッケージテストで、温度などの環境を変えたり、パラメータを変えてテストするなど、ミッションクリティカルな用途の半導体向けでは、テスト量が増加すると見込んでいる。

以上

※本資料に記載されている内容は、決算説明会の質疑をもとに当社の判断で要約したものです。また本資料には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれております。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているものまたは暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。